

2017年3月期 連結業績見通し及び 中期経営方針について

代表取締役社長
上釜 健宏

皆様こんにちは。本日はどうもありがとうございます。それでは私のほうから2017年3月期連結業績見通し及び中期の経営方針をご説明申し上げます。

2017年3月期 連結業績見通し

2017年3月期 連結業績及び配当金見通し

(億円)	2016年3月期 通期実績	2017年3月期 業績予想	業績予想対前期比	
			増減	増減率(%)
売上高	11,523	11,600	77	0.7%
営業利益	934	740	△ 194	-20.8%
営業利益率	8.1%	6.4%	-1.6 pt	-
税引前利益	918	730	△ 188	-20.5%
当期純利益	648	500	△ 148	-22.8%
1株当たり利益(円)	514.23	396.00	-	-
配当金	上期：60円 下期：60円 年間：120円	上期：60円 下期：60円 年間：120円	-	-
為替	対ドルレート	120.13	110.00	-
	対ユーロレート	132.67	125.00	-
固定資産の取得 (設備投資)	1,607	2,000	393	24.5%
減価償却費	832	950	118	14.2%
研究開発費	849	900	51	6.0%

Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 3 -

まず、2017年3月期連結業績は、売上高1兆1,600億円、営業利益740億円、営業利益率6.4%、税前利益730億円、当期純利益500億円、一株利益396円を計画しております。配当金見通しは、前期と同様上期60円、下期60円、年間120円を計画しております。為替は対米ドルで110円、対ユーロで125円を想定しております。設備投資は、前期より増加させて約2,000億円を見込んでおります。減価償却費は950億円、研究開発費は50億上乗せして900億円を見込んでおります。

2017年3月期 通期連結売上高増減イメージ

(億円)

セグメント区分	2016年3月期 通期実績	2017年3月期 通期予想 (対前年比)
受動部品	5,757	+3~+6%
磁気応用製品	3,153	-11~-14%
フィルム 応用製品	2,224	+12~+15%
その他	388	-
合計	11,523	11,600

為替前提

為替レート \$/Yen	120.13
為替レート EURO/Yen	132.67

110.00
125.00

Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 4 -

通期連結売上のセグメント別の増減イメージでございます。受動部品は好調に推移し、為替の円高を考慮しても前期から3~6%上ぶれると見ております。磁気応用製品は、マイナス11%~14%。減少の要因はHDDヘッドです。フィルム応用製品は12%~15%增收になるだろうと想定しております。為替前提110円で合計1兆1,600億円、前期比でほぼ横ばいとなります。受動部品と二次電池が為替円高分をカバーしてプラス成長を見込む一方で、HDDヘッドが減少するというイメージで捉えていただきたいと思います。

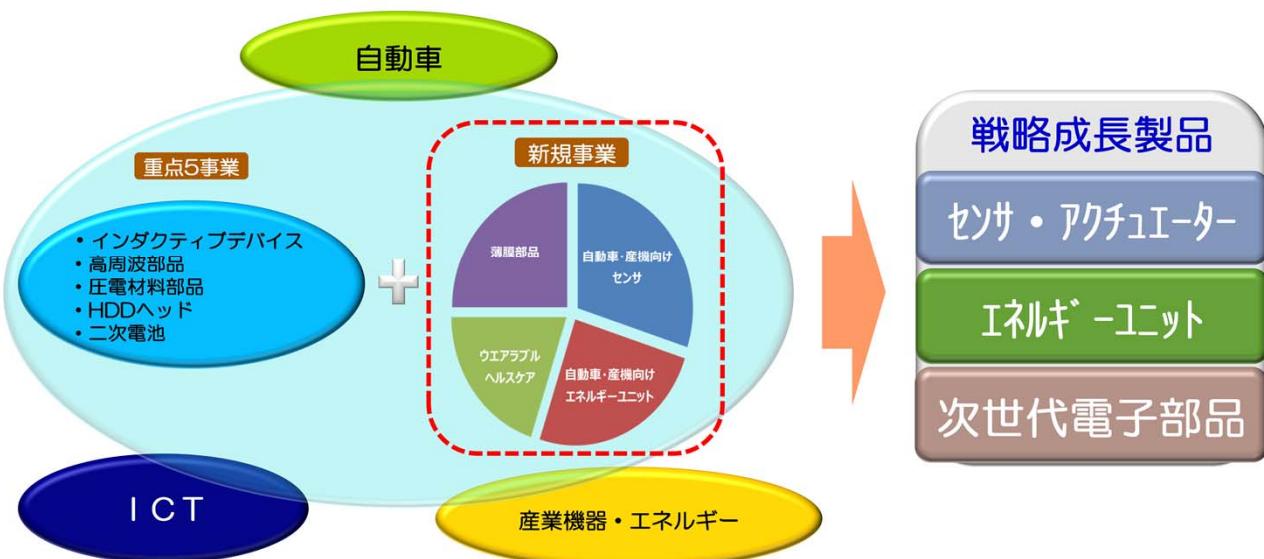
2017年3月期 のポイント

セグメント	主要事業の見通し
受動部品	<ul style="list-style-type: none"> インダクタ：ICT、車載市場向け薄膜製品、積層製品のシェア拡大 高周波部品：小型・高特性ディスクリート品やモジュールの販売拡大 圧電材料部品：OISビジネスの拡大（中国スマホ搭載率増）
磁気応用製品	<ul style="list-style-type: none"> HDDヘッド： PC需要減少とSSD化加速によるHDD市場台数縮小 16/3期 約4.44億台 ⇒ 17/3期 約4.0億台（10%減） センサ：車載市場向けセンサの拡大、ミクロナスの寄与
フィルム 応用製品 (二次電池)	<ul style="list-style-type: none"> 二次電池：モバイル機器薄型化によるポリマー電池需要の拡大継続 新規アプリケーション需要の拡大 需要に見合った生産拡大投資及び合理化投資の継続

各セグメントのポイントを説明いたします。まず受動部品ですが、インダクタは、ICTや車載向けの薄膜部品及び積層品のシェアが拡大してくるだろうと見込んでおります。高周波部品については、小型のディスクリート品やモジュールの販売が拡大すると見込んでおります。圧電材料部品は、手振れ補正用OISの販売が拡大してくると見込んでおります。中国スマホでの搭載率が増えてくるだろうと見ております。磁気応用製品は、PC需要の減少とPC内でのSSD化が加速されることでHDDの市場台数が縮小していくと想定しています。前期の2016年3月期は約4億4,400万台でしたが、今期2017年3月期は約4億台、約10%減ると見込んでおります。磁気センサにつきましては、車載市場向けのセンサが拡大すると見ています。買収が完了したミクロナスの損益が今期は通期で寄与してきます。フィルム応用製品、特に二次電池ですが、モバイル機器の薄膜化によるポリマー電池需要の拡大が継続すると見ています。また、ドローンや電動工具等の新規アプリケーションの需要も拡大すると見ています。二次電池に関しては引き続き事業に見合った生産拡大投資及び合理化投資の継続をしていきたいと考えております。以上が2017年3月期の連結業績の見通しでございます。

中期経営方針

中期重点事業と戦略成長製品

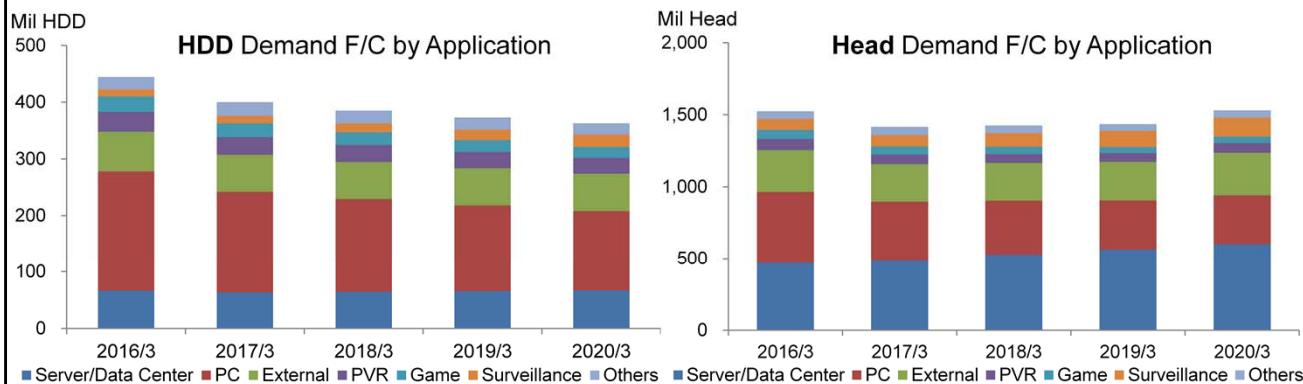


2015/3通期決算説明会(2015/4/28)

続きまして中期経営方針についてご説明いたします。今までも中期重点事業ということで、重点5事業と重点分野は自動車、ICT、産機エネルギーを申し上げてきました。しかしながら、ここにきてHDDの状況が悪くなっています。また、高周波部品事業はクアルコムと設立するジョイントベンチャーに移管されます。ここで本日は、スライドの右側に記載しております戦略成長製品として、センサ・アクチュエーター、エネルギー・ユニット、次世代電子部品の3つについて特に説明をさせていただきたいと思っております。

記録デバイス事業(HDD ヘッド)について

◆HDD市場/HDD ヘッド需要動向 (2016/3~2020/3)



- **HDD市場の縮小傾向継続**
(16/3期4.44億台→20/3期3.63億台)
- PC市場の縮小及びPCのSSD化の加速
- 高速処理用ハイエンドHDDもSSDへの代替が加速
- ニアライン、外付け、監視カメラ向け
HDD需要は、堅調に推移

(当社推定)

- HDD市場は縮小もHDDヘッド需要は横這いで推移
- PC用HDDヘッド需要は縮小継続
- ニアライン用HDDヘッドを中心に
HDD1台当たりの搭載本数が増加
(16/3期：3.43本→20/3期：4.22本)

(当社推定)

Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 8 -

まずその前にHDDヘッド事業の状況が気になると思いますので、HDDヘッドについて説明いたします。HDD市場台数は先程も申し上げました通り減少しています。ただしニアライン、外付け、監視カメラ向けのHDDの需要は伸びるだろうと見ています。HDDヘッドの市場本数の需要は横ばいで推移するだろうと見ております。背景としては、HDD1台あたりの搭載本数は、2016年3月期には3.43本1台あたりであったのが、2020年3月期には4.22本まで増えるだろうと見ています。

記録デバイス事業(HDD ヘッド)について

自社のライトサイジング実施と業界ライトサイジングへの貢献

①自社のライトサイジング

- 前工程拠点 : 2拠点→1拠点に集約
- 後工程拠点 : 中国の体制リストラ、フィリピンでの受動部品生産の開始

②業界ライトサイジングへの貢献

- Non-captive : 従来の枠組みを超えた開発・製造の垂直的協業の強化
- Captive : 重複投資やコスト増を回避する水平分業
Time-To-Marketを支援する先端技術開発支援

③先端技術力による製品・サービスの提供

- 熱アシストヘッド(TAMR : 前工程及び後工程)、二次元記録(TDMR)、マイクロDSAの実現
- 後工程技術力によるサービス提供

縮小する市場で “必要とされる存在” であり続ける。

そういう市場前提の中で今後どのような施策を打っていくのかということになりますが、実際にもう手を打っているものもありますし、今から打つものもあります。1点目が自社のライトサイジング。これは生産拠点の最適化であり、前工程拠点を2拠点から1拠点に集約いたします。後工程拠点につきましても、中国拠点での構造改革を3月に実施し、計上いたしました。また、フィリピンの受動部品生産も開始して、HDDヘッドの拠点を電子部品に転換すること既に開始しております。それから、2点目が業界のライトサイジングへの貢献。ここは非常にわかりづらいと思いますが、HDDヘッドを内製されていないお客様とは、従来の枠組みを超えた開発、製造の垂直的協業の強化を行い、HDDヘッドを内製されているお客様とは重複投資やコスト増を回避する水平分業を模索していきたいと考えております。また、タイム・トゥ・マーケットを支援する先端技術開発を実施していきたいと考えております。3点目は、先端技術力による製品サービスの提供であり、これは今まで研究をやり続けてきたわけですが、今後ますます力を入れていきます。熱アシストヘッド、二次元記録(TDMR)、薄膜マイクロDSA(アクチュエーター)等の新技術開発に注力していきます。HDD市場は残念ながら縮小傾向を辿っていきますが、その市場で必要とされる存在であり続けたいと考えております。

当社の成長戦略 (IoT市場へ向けた戦略成長製品)

Qualcomm社との協業体制強化によって戦略成長製品の拡大を加速
→重点市場を通してIoT市場における事業機会獲得

Internet of Things (IoT)

重点市場



Qualcommとの協業体制の強化

続きまして、戦略成長製品(①センサ・アクチュエーター、②エネルギー単位、③次世代電子部品)について説明いたします。先程も説明いたしましたが、クアルコムとのシナジーもかなり入っております。ほとんど全部に関係するのではないかと思います。

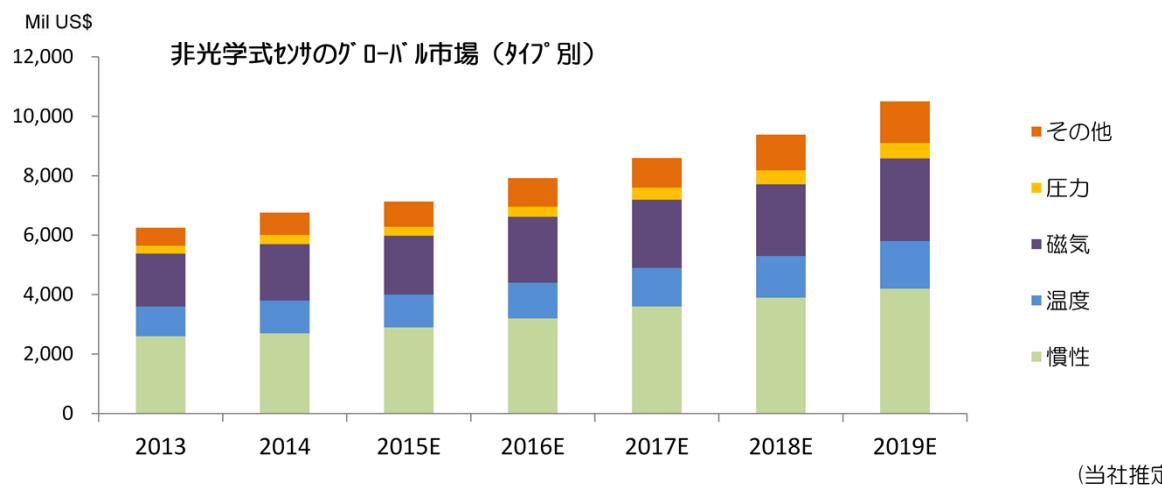
センサ・アクチュエーター

市場予測

非光学式センサ市場：
68億ドル／2014年⇒106億ドル／2019年



年率9.1%成長



Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 11 -

まず初めに、①センサ・アクチュエーターの中のセンサ市場の予測でございます。こちらのスライドは非光学式センサ市場の見通しになりますが、2014年には68億ドルの市場規模であったものが、2019年には106億ドルの市場になると見込まれています。棒グラフの下から慣性センサ、温度センサ、磁気センサ、圧力センサとありますが、これら全部の製品に取り組みたいと考えております。今まででは磁気センサの話をよくさせていただいていましたが、磁気センサについてはもう大体道筋が決まりましたので、次は温度センサも圧力センサも車載向けを中心に展開していきます。また、今後は慣性センサにも取り組んでいきたいと思っています。

センサ・アクチュエーター

磁気センサ事業の拡大戦略

モジュール・センサシステムの事業拡大

- ・センサアッセンブリ技術の融合
- ・中国拠点を活用したローカルビジネスの拡大

Micronas社とのシナジー最大化

- ・ホール+TMRハイブリッド型車載向けセンサ
- ・ASIC/ASSP技術のTDK製品への展開

民生用途需要取り込みによる事業拡大

- ・高精度、省電力特性による新規需要の拡大

車載向けTMRセンサの事業拡大

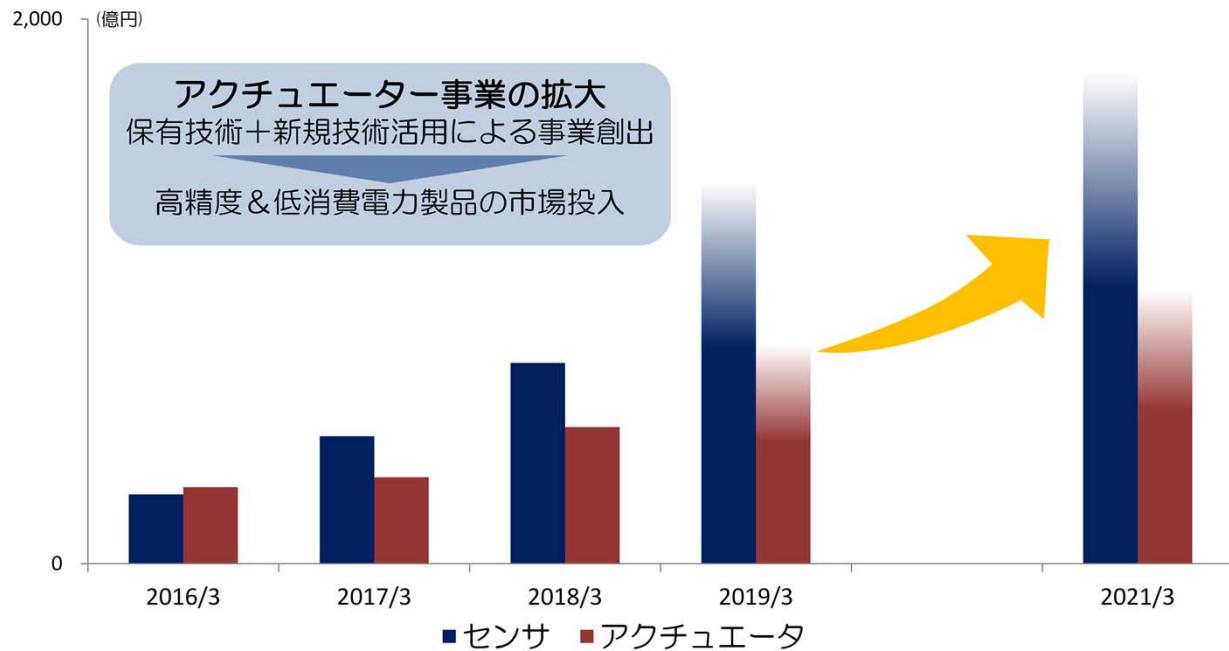
- ・主要製品ラインアップの開発完了（17/3期）
- ・アプリケーション、顧客基盤の拡大

次に磁気センサ事業の拡大戦略になりますが、4つのステップでやってまいります。まず、車載向けのTMRセンサの事業を拡大です。主要製品ラインナップの開発については今期に完了します。現在40社位のお客様のご承認が完了するだろうと見ております。

アプリケーションの拡大や顧客基盤の拡大を図ってまいります。次のステップは、民生用途需要取り込みによる事業拡大です。TMRセンサは高い精度を持っている点と非常に省エネである点を高く評価されていまして、非常に可能性が大きいと考えております。現在は車載向けが中心ですが、コンシューマ向けに採用されると、数が車載と比べてかなり増加しますし、製品サイズが車載用のセンサよりも10分の1程度のサイズになります。そうしますと素子の取り数がかなり増えますので、効率的なビジネスが展開できると考えております。3つ目がミクロナスとのシナジーの最大化です。ミクロナスはホール素子です。TDKはTMRです。ホール+TMRのハイブリッド型車載向けセンサを開発していく多様なニーズに対応します。それから、ミクロナスが持っているASICやパッケージング技術をTDKの製品で展開しますので、ミクロナスが非常に強い分野との融合で様々なシナジーが創出できるだろうと考えています。4つ目のステップは、センサユニット、モジュール、センサシステムの事業拡大です。システムまで持っていきたいと考えています。中国拠点を活用したローカルビジネスも拡大していきたいと考えています。この4つのステップで磁気センサの事業を拡大してまいります。

センサ・アクチュエーター

センサ及びアクチュエータ事業の拡大（売上）



アクチュエーターについても少し触れます。保有技術プラス新規技術活用による事業創出と書いてありますが、アクチュエーターには様々な製品がありますが、成長戦略製品に含めているものとしては、主にスマホのカメラモジュール用の手振れ防止に使OIS (Optical Image Stabilizer)になります。現在中国のスマホメーカー様にご承認をいただいて量産しております。グラフは、センサとアクチュエーターの売上のイメージになります。センサの売上には先日買収が完了したミクロナスの売上も入っています。

エネルギー単品

“単品からシステムへ”

電力変換機能、蓄電機能、エネルギー制御機能を持つ
ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたユニットを提供

電力変換機能

- AC-DC & DC-DCコンバータ
- インバータ
- チャージャー
- 回生エネルギー用双方向 AC-DC & DC-DCコンバータ
- 非接触給電

蓄電機能

- 産機用リチウムイオン電池
- 車載用リチウムイオン電池
- ESS (Energy Storage System)用リチウムイオン電池
- EDLC (電気二重層コンデンサ)

エネルギー制御機能

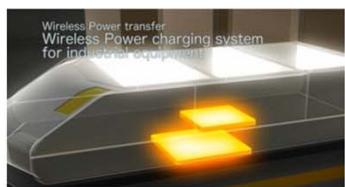
- BMU (Battery Management Unit)
- BMS (Battery Management System)
- 各種センサ (電流センサ、温度センサ等)

次はエネルギー単品について説明いたします。エネルギー単品の定義は、電力変換機能、蓄電機能、エネルギー制御機能を持つハードウェアとソフトウェアを組み合わせたユニットということになります。例えば電力変換機能に関する製品にどういったものがあるかということになりますが、当社はACDCコンバータ、DCDCコンバータ、インバータ、チャージャー、回生エネルギー用双方向ACDC、それから非接触給電があります。この辺りを全部ユニットとして提供していきたい。今まで単品で販売をやっていましたが、やはりシステムとして併せたほうが良いと考えております。蓄電機能としては、産機用リチウムイオン電池、車載用リチウムイオン電池、EDLC(電気二重層コンデンサ)等がありますが、これらを提供してまいります。エネルギー制御機能としては、バッテリーマネジメントユニットシステムからここに使用される各種センサ、特に電流センサと温度センサがあります。これらも全部内蔵し、全部を組み合わせた形でエネルギー単品として販売していくということを考えております。

エネルギー ユニット



AGV(Auto Guided Vehicle)



Mobile Robot



Hand of Robot

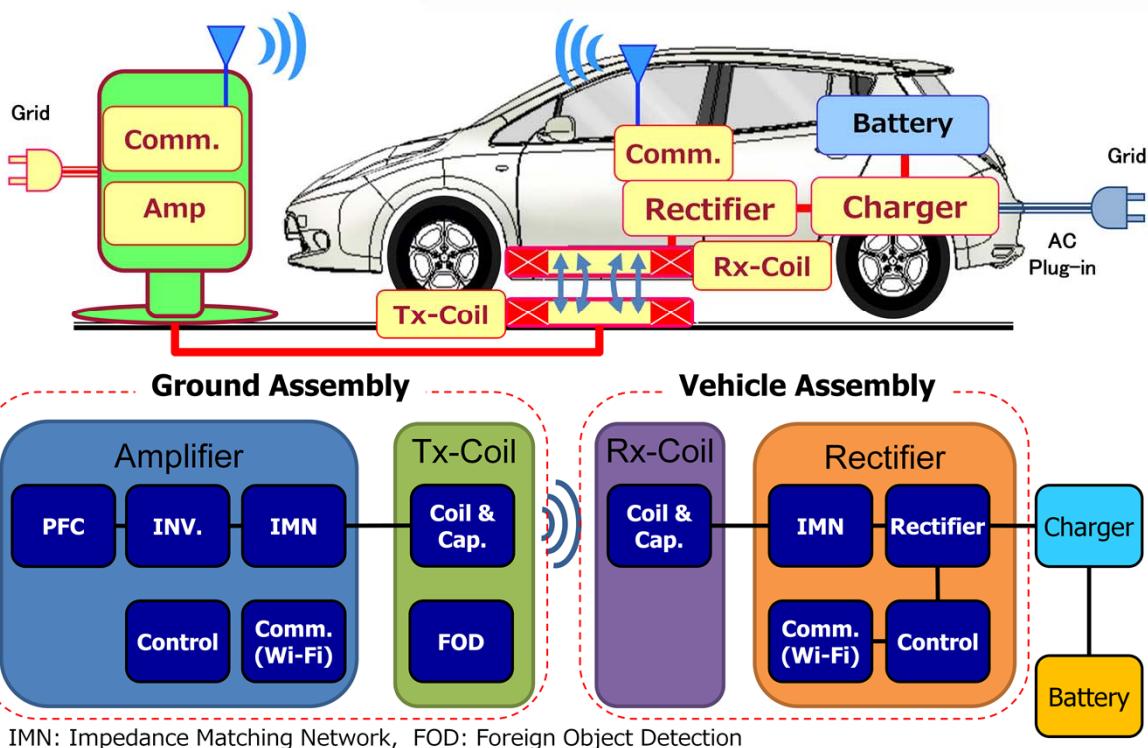


Pendant
for CNC

例としては、産機用ですとAGVがあります。非接触給電も組み合わせます。それから、モバイルロボットやハンドロボットなどもあります。アームの箇所、要は回転するところに使用していくことになります。

エネルギー単位

WPT System - Overview & Functions



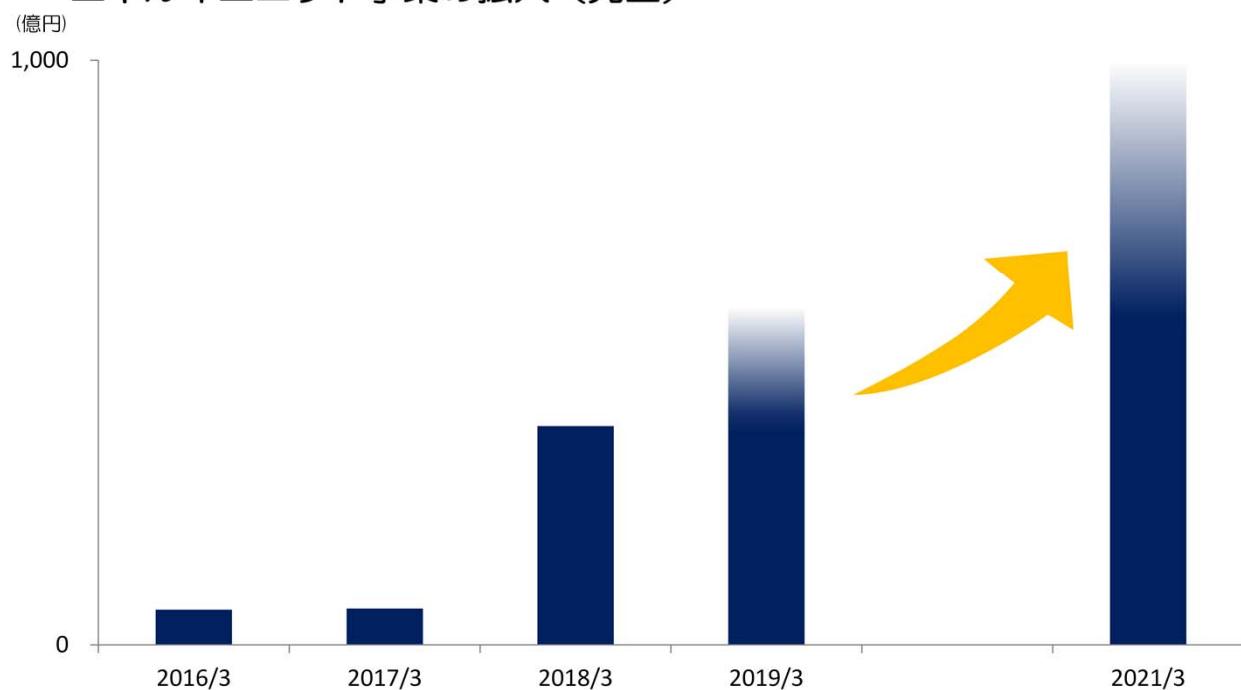
Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 16 -

こちらのページは車載向け非接触給電のイメージ図です。非接触給電を中心に、図のような形でオンボードチャージャーからDCDCコンバータ、各種センサをつけていく形でシステムとして販売していきたいと考えております。

エネルギー ユニット

エネルギー ユニット事業の拡大（売上）



Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 17 -

そのエネルギー ユニットの売上げのイメージでございます。今はまだ規模は小さいですが、2018年3月期から売上げが立つてくるイメージです。これは車載向けですので2018年3月期の分は既に承認されていると思って下さい。ですからグラフもぼかしておりません。2019年3月期以降は、まだ承認がはっきりしないものもありますので若干グラフもぼかしてありますが、イメージの通り確実に増えてまいります。

次世代電子部品

『SESUB技術』・『薄膜技術』・『材料技術』を融合させ、
今後多様化する顧客ニーズに応える 高付加価値製品を提供する

SESUB技術

薄膜技術

材料技術



次世代電子部品

- SESUB
- 複合部品
- 薄膜高周波フィルタ
- 薄膜コンデンサ（シート・個品）
- MEMS
- 低背インダクタetc.

次は次世代電子部品について説明させていただきます。これはクアルコム社とのシナジーがかなり大きいものになります。SESUB (Semiconductor Embedded Substrate: IC内蔵基盤)技術、薄膜技術、材料技術、これらを融合させてさらに付加価値の高い次世代電子部品、あるいはモジュールを提供していくこうということでございます。

次世代電子部品

最先端技術を導入し製品ライナップを拡大
受動部品内蔵のSESUBで更なる薄型パッケージを実現

SESUB

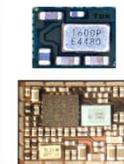
パワー系

μ DC/DCコンバータ
エンベロープトラッカー
LiBチャージャー



通信系

BLEモジュール
WiFiモジュール
PA/RFモジュール



薄膜デバイス

パワー系 通信系 センサ系 ノイズ系 CPU

薄膜コンデンサ
低背インダクタ
高周波フィルタ
薄膜コモンモードフィルタ
MEMSマイクロフォン
埋め込み型コンデンサ



ASE社とのJVを最大活用し、SESUBビジネスを本格拡大

SESUB、複合部品、薄膜高周波フィルタ、薄膜コンデンサ、薄膜モードフィルタ、埋め込み型コンデンサ、MEMSマイクロフォン、低背インダクタ等々、今開発中のものもありますし、もう量産し始めたものもございます。

次世代電子部品

ルネサスセミコンダクタ マニュファクチャリング鶴岡工場の買収

合意の背景

- ・秋田地区での薄膜受動部品製造拠点の構築
- ・薄膜製品製造技術力の確保
- ・将来の拡大に向けた生産スペースの確保

鶴岡工場 空撮

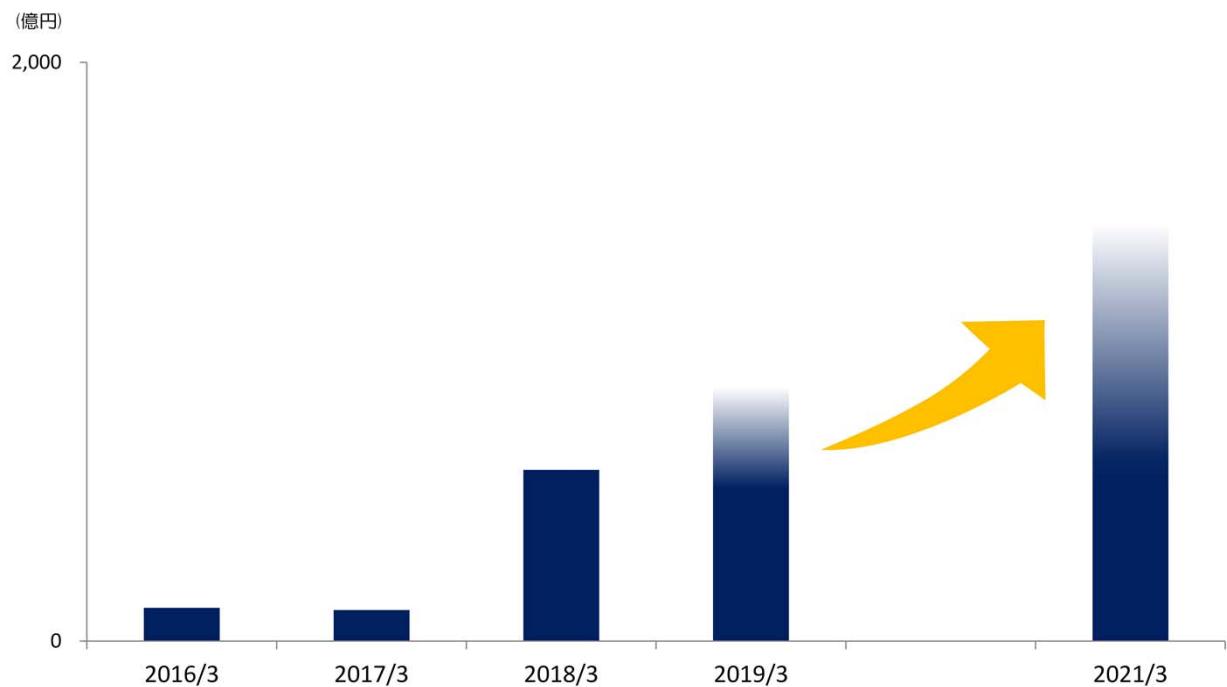


※ ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチャリング(株)様資料より

次世代電子部品、特に薄膜部品強化を目的に、ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング様の鶴岡工場を買収いたします。今まででは甲府工場の薄膜デバイスセンターという部門で、薄膜部品の開発から量産までを手がけてきたのですが、やはり手狭になってまいりましたので、新しい工場が必要になっていました。秋田に新工場も作っているのですが、そこはまた別の使い方を考えておりますので、別の高度なクリーンルームを保有した拠点が必要となりました。特にルネサス様の鶴岡工場は、車載用製品の製造経験のある工場であり、従業員の方々のその分野でのご経験やノウハウ、関連したリソースもありますので、非常に魅力的に感じ買収を決定いたしました。この鶴岡工場で今後薄膜部品をさらに拡大していくということでございます。

次世代電子部品

次世代電子部品事業の拡大（売上）



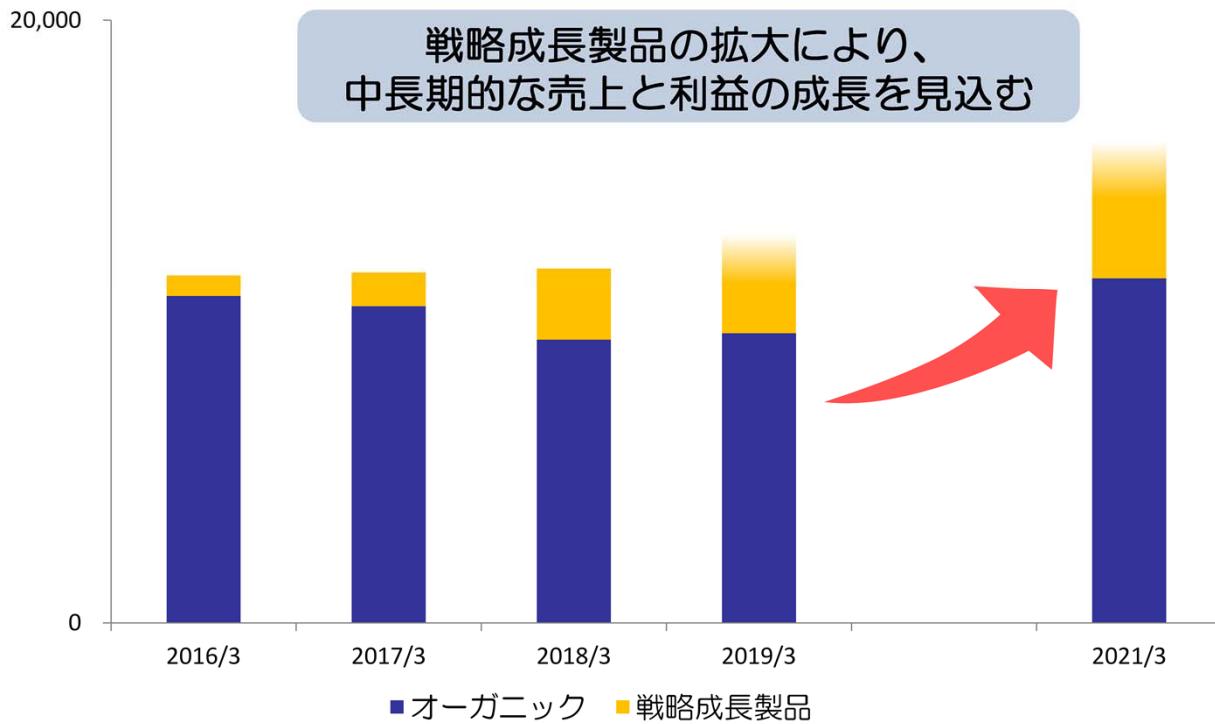
Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 21 -

次世代電子部品の売上げは、グラフのようなイメージで考えております。

全社 売上見通し

(億円)

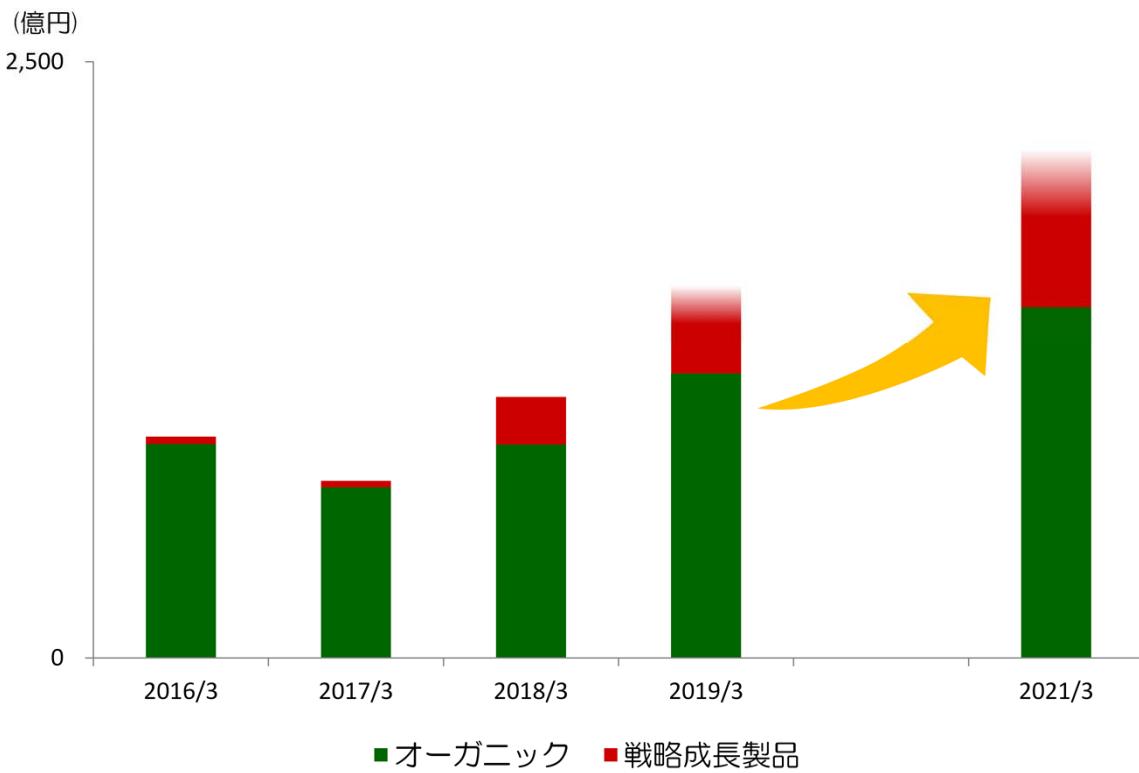


Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 22 -

今ご説明させていただきました戦略成長製品も含めた全社の売上見通しです。黄色い部分が戦略成長製品、青い部分がオーガニックな拡大になります。2017年3月期は横ばいです。2018年3月期は高周波部品事業がクアルコム社と設立する合弁会社に移管されますので、オーガニックな売上げは下落します。ただ、戦略成長製品でカバーできると考えています。2019年3月期以降は、戦略成長製品をさらに伸ばすことで、全体の成長を実現していきます。

全社 営業利益見通し



Copyright® 2016 TDK Corporation. All rights reserved.

- 23 -

こちらのページは営業利益のイメージを示しています。2018年3月期から営業利益再び伸ばしていく計画です。早期に全社でも二桁利益率を達成したいという思いでございます。

中期経営目標

成長投資

- ・新製品、新規事業への投資、M&A
- ・既存事業の生産能力増強

株主還元

- ・EPS成長を通じ安定配当、増配
- ・配当性向30%目標



	2015年3月期実績	2018年3月期目標
営業利益率	6.7%	10%以上
ROE	7.2%	10%以上

これは中期計画で前回も掲げた目標でございます。2018年3月期に10%という目標は変更しておりません。この目標はぜひ達成したいと思っております。

成長投資

中計期間の総投資額
(16/3-18/3期)

設備投資

- 戰略成長製品の拡大加速
- 既存重点事業の拡大加速

3,500～4,000億円

4,300～4,800億円

R&D投資

- 海外R&Dの拠点強化
- ものづくり改革の加速

約2,300億円

約2,500億円

中期計画（オリジナル）

最新見込み

最後になります。設備投資と研究開発費です。前回設備投資計画については、中期の3年間(2016年3月期～2018年3月期)で3,500億円から4,000億円と公表しておりましたが、やはり成長戦略製品や既存の重点製品にも投資をしていくため、投資を800億円増やし、4,300億円から4,800億円を現在は計画しております。研究開発費も200億増やして2,500億を計画しています。3年間で投資も開発も増えましたが、できるだけ前倒しして、様々な事業を先取りしていきたいと考えております。以上で私の説明は終わりますが、リリースで皆様ご存じかと思いますが、社長を次の有能な社長に譲って、私は会長職として今後は会社に関わろうと思っております。私は、今までこのIRの席は15年前から出席させていただいていまして、皆様の前で説明させていただく機会は本日で恐らく最後になると思います。次回からは新社長が説明することになると思います。本当に皆様ありがとうございました。今後今まで以上の弊社へのご支援をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。

将来に関する記述についての注意事項

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または默示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与える得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

又、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。



決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は以下のページに後日掲載をいたします。
http://www.tdk.co.jp/ir/ir_events/conference/2016/4q_1.htm